Sub-micron Particle Imaging Module

서브미크론 표면 결함 검출용 고속 대면적 레이저 산란 이미징 모듈

Imaging Module

앤비젼에서 개발한 레이저 산란 이미징 모듈은 일반적인 이미지 광학계와 Multi 라인 레이저 산란 광학계를 결합하여 Sub-micron 크기의 표면 파티클 신호 또는 이미지를 얻을 수 있도록 개발되었습니다. 이 모듈은 다양한 조건의 이미지를 동시에 얻을 수 있기 때문에 패턴 웨이퍼 같은 제품의 표면 검사를 위한 다양한 이미지를 제공할 수 있습니다. 또한 높은 품질의 이미지를 얻기 위한 고속 자동 초점 장치가 적용되어 있습니다.

자동 광학 검사기는 분야와 제품에 따라 다양한 배율의 이미지 광학계가 적용되는데, 이 자동 초점 장치는 1.67배에서 10배까지 모두 대응할 수 있도록 라인업이 구성되어 있습니다.

특징

- 레이저 산란방식의 고속 검사 기기
- 넓은 라인스캔 FOV : 24mm
- Pixel resolution: 1.5μm/pixel
- 커스텀 개발 가능

애플리케이션

- OLED Bare Glass 표면 결함 검사

사양

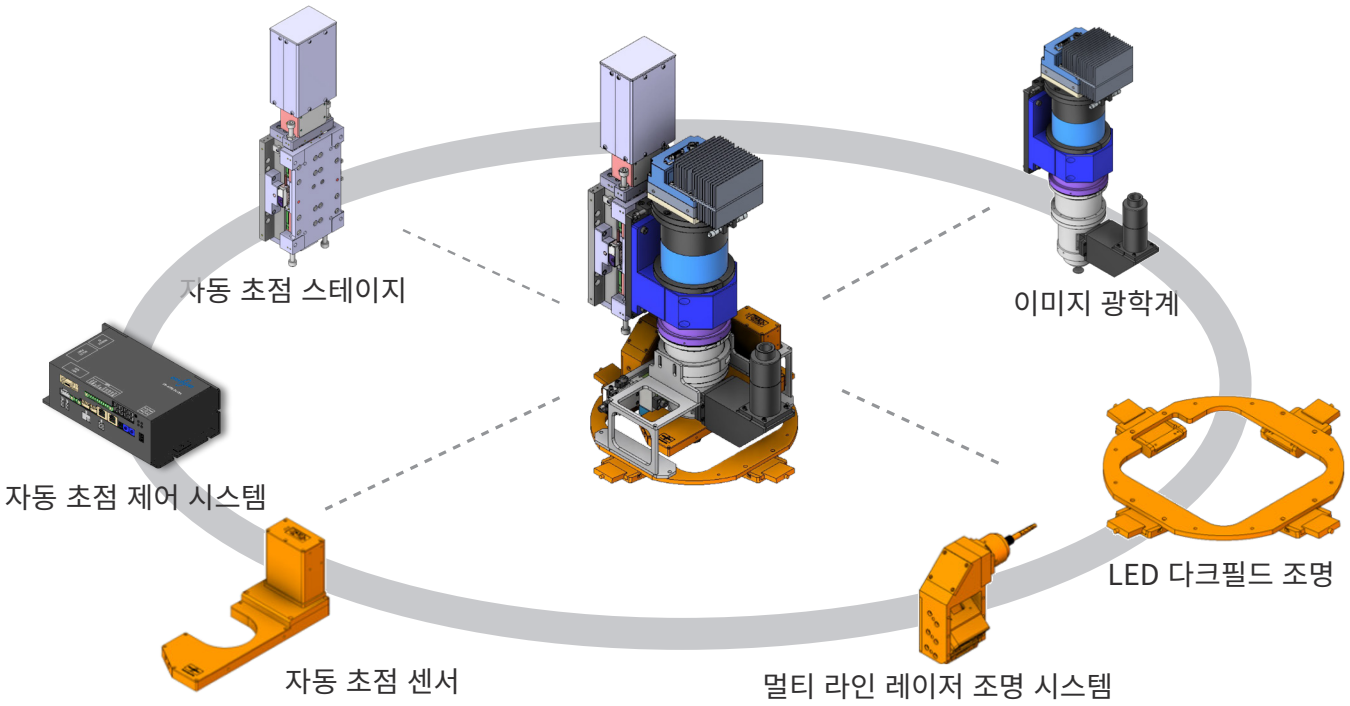
이미징모듈	Pixel resolution	0.5μm/pixel
	FOV	8mm
	Max. scan speed	66mm/s @133kHz & 3-channel
	레이저 산란 검출 감도	0.2μm ↑ @40mm/sec 0.3μm ↑ @66mm/sec
카메라	Model	Linea HS Multifield (MF3)
	Resolution	16,384pixel x 256pixel (Red 64 + Blue 128 + Green 64)
	Line rate	400kHz 1-channel 400kHz 2-channel 180kHz 3-channel 133kHz
	Pixel size	5μm
렌즈	Magnification	10x
	Image circle	82mm
LED 비축 (D/F) 조명	LED Color	Green
	Incident Angle	82°
멀티라인 레이저 조명	Wavelength	520nm / 648nm
	입사 각도	50° / 60° / 70°
	Output Power	0 ~ 2 W
AF 시스템	Settling precision	< 0.5μm
	Max load	20kg
	Sensing range / Focusing range	±400μm / 26mm
	Com type	Ethernet

envision (08506) 서울시 금천구 가산디지털 2로 98, 1동 603호 sales@envision.co.kr www.envision.co.kr 02-2624-5503

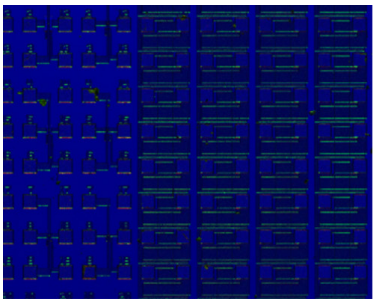
Sub-micron Particle Imaging Module

서브미크론 표면 결함 검출용 고속 대면적 레이저 산란 이미징 모듈

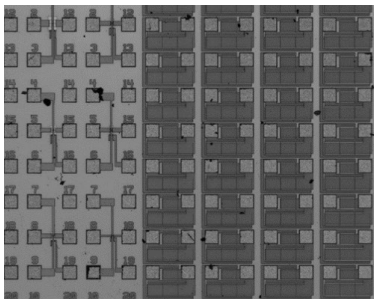
고속 대면적 레이저 산란 이미징 모듈 구성



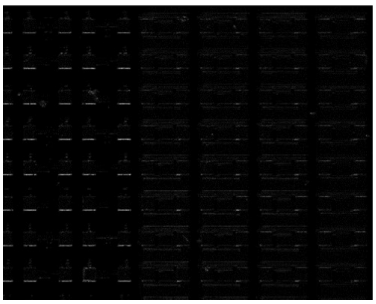
애플리케이션



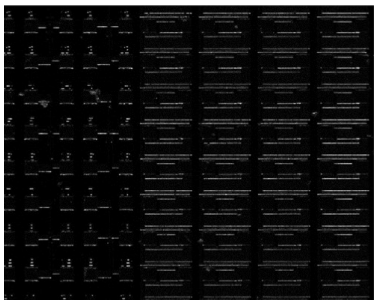
컬러 이미지



동축 조명 이미지 Blue channel



저출력 638nm 레이저 산란 이미지 Red channel



고출력 520nm 레이저 산란 이미지 Green channel

envision (08506) 서울시 금천구 가산디지털 2로 98, 1동 603호 sales@envision.co.kr www.envision.co.kr 02-2624-5503